

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2026-038

债券代码：128136

债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

关于申请增加银行间债券市场非金融企业债务融资工具（DFI）

发行规模的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）于2026年4月14日召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《公司关于申请增加银行间债券市场非金融企业债务融资工具（DFI）发行规模的议案》，同意公司向股东会申请增加80亿元人民币的债务融资工具（DFI）发行规模，本次增加发行规模后债务融资工具（DFI）项下各类债券规模余额合计不超过200亿元人民币。具体情况如下：

为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，增强资金管理的灵活性，保障持续健康发展的资金需求，公司于2024年8月23日召开的第六届董事会第二次会议、2024年10月9日召开的2024年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具（DFI）的议案》，同意公司发行债务融资工具（DFI）项下各类债券规模余额合计不超过人民币120亿元，具体内容详见公司在深圳证券交易所网站披露的《立讯精密工业股份有限公司关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具（DFI）的公告》（公告编号：2024-069）。

公司于2024年11月21日收到中国银行间市场交易商协会（简称“交易商协会”）出具的编号为“中市协注（2024）DFI64号”《接受注册通知书》，详见公司在深圳证券交易所网站披露的《立讯精密工业股份有限公司关于银行间债券市场非金融企业债务融资工具（DFI）注册申请获准的公告》（公告编号：2024-094）。

为进一步满足公司业务发展的资金需求，降低融资成本，公司拟向股东会申请增加80亿元人民币的债务融资工具（DFI）发行规模，本次增加发行规模后债务融资工具（DFI）项下各类债券规模余额合计不超过200亿元人民币。根据相关法律法规的规定，本次增加发行规模后的发行方案及授权事项具体如下：

一、本次拟发行债务融资工具（DFI）的具体方案

- 1、发行人：立讯精密工业股份有限公司；
- 2、发行品种：包括超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具、定向债务融资工具等；
- 3、发行规模及期限：公司将根据实际经营情况，确定每期发行品种、额度和期限等，DFI项下各类债券规模余额合计不超过200亿元人民币，并在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机分期发行；
- 4、发行利率：发行利率根据发行时市场情况，通过簿记建档、集中配售方式最终确定；
- 5、注册有效期：取得中国银行间市场交易商协会同意注册批文之日起2年内有效；
- 6、发行对象：银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）；
- 7、发行方式：本次发行债务融资工具（DFI）由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发售；
- 8、承销方式：主承销商以余额包销的方式承销本债券；
- 9、募集资金用途：本次注册发行债务融资工具（DFI）募集资金用于发行人本部及下属公司偿还金融机构借款、补充营运资金、偿还信用债券等交易商协会认可的用途。

二、董事会提请股东会授权事项

为提高融资效率，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请股东会授权公司董事长根据公司资金需要、业务情况以及市场条件全权决定和办理与本次债务融资工具（DFI）发行有关的具体事宜，主要包括但不限于：

1、在法律法规允许的范围内，决定或修订、调整本次发行债务融资工具（DFI）的发行额度、发行期限、发行期数、发行利率、发行方式、承销方式、担保方式、募集资金用途等与本次发行债务融资工具（DFI）相关的具体事宜；

2、聘请本次发行的主承销商及其他中介机构；

3、签署与本次债务融资工具（DFI）发行有关的各项文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书和承销协议等；

4、办理与本次债务融资工具（DFI）发行有关的各项手续，包括但不限于办理本次债务融资工具（DFI）的发行及交易流通等事项的有关手续；

5、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由公司股东会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次发行债务融资工具（DFI）的具体方案、发行条款等相关事项进行相应修订、调整；

6、办理与本次发行债务融资工具（DFI）有关的其他事项；

7、本次授权有效期限自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，该议案需提交公司股东会审议。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2026年4月14日